

【採択事業一覧】

申請者	事業概要
三和産業(株) (下松市)	<p>【事業の名称】 半導体製造装置向けチタン表面技術の開発</p>
<p>《問い合わせ窓口》 技術開発主任 中村 健二 TEL : 0833-41-3076</p>	<p>【事業内容】 半導体製造装置の高性能化に必要なチタン構造材への耐電圧付与を目的とする、アノード酸化技術を用いたチタン表面処理技術の開発</p>
ファインマテリアルシステム(有) (宇部市)	<p>【事業の名称】 半導体フォトマスク作成用の化学材料の開発</p>
<p>《問い合わせ窓口》 山口事業所長 河田 敦 TEL : 090-4249-3751</p>	<p>【事業内容】 光学系半導体などのフォトマスク(※)作成に使用されるパターン形成材料の開発と品質保証体制の構築</p> <p>※フォトマスク 半導体基板に回路を転写するための回路の原板</p>
リード(株) (宇部市)	<p>【事業の名称】 半導体用微細チップのバリ取り技術の開発</p>
<p>《問い合わせ窓口》 部長 岡田 孝宏 TEL : 0836-62-1531</p>	<p>【事業内容】 半導体用放熱材などをダイシング(※)して微細チップにする際に発生する金属バリについて、効率的で安定的かつ環境にも配慮した安全なバリ取り技術の開発</p> <p>※ダイシング 高精度に切断する工程</p>